

6. 處分不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。
7. 與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上。(附表六)
8. 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上。(附表七)
9. 從事衍生工具交易：請參閱附註七及十。
10. 其他：母子公司間及各子公司間之業務關係及重要交易往來情形及金額。(附表八)
11. 被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊(不包含大陸被投資公司)。(附表九)

(三) 大陸投資資訊：

1. 大陸被投資公司名稱、主要營業項目、實收資本額、投資方式、資金匯出入情形、持股比例、本期損益及認列之投資損益、期末投資帳面價值、已匯回投資收益及赴大陸地區投資限額：請參閱附表十。
2. 與大陸被投資公司直接或間接經由第三地區所發生之重大交易事項，暨其價格、付款條件、未實現損益及其他有助於瞭解大陸投資對財務報告影響之有關資料：請參閱附表八。

(四) 主要股東資訊：

股權比例達 5% 以上之股東名稱、持股數額及比例。(附表十一)

三七、營運部門資訊

依據主要營運決策者定期複核用以分配資源及績效衡量之營運結果，著重於晶圓代工事業整體業務所產生之營業損益，是以本公司僅有晶圓代工事業部門之單一營運部門。晶圓代工事業部門主要係從事於有關積體電路及其他半導體裝置製造、銷售、封裝測試與電腦輔助設計及光罩製造等代工業務。

本公司營運部門之營業損益衡量基礎與財務報表編製基礎一致，相關部門收入與營運結果請參閱合併綜合損益表。